

弊社 P-Flex™ (PET と PI) と一般的な FPC との比較表

	製造方法	弊社の手法 ピュアアディティブ法 (インクジェット印刷+無電解銅めっき)	従来手法 サブトラクティブ法 (銅張り積層板をエッチング)
製造プロセス	ベース基材	耐熱 PET	ポリイミド
	型/初期費用	不要	必要
	ロット数	試作~大ロットまで柔軟に対応	試作~大ロットまで柔軟に対応
	納期	標準で3日	標準で3日
製造仕様	配線層	片面1層のみ	片面1層のみ
	基材厚	50μm (125μm も特注対応可)	25μm
	総膜厚	73μm	48μm
	L/S	200μm / 200μm (200 / 150μm は追加費用・納期で対応)	200μm / 200μm (200 / 150μm は追加費用・納期で対応)
	銅膜厚	3μm (6μm はオプションで対応)	3μm
環境試験	耐屈曲性	R = 5mm で 2000万回以上 一度折りは R=0.5mm 対応可	近日中に掲載予定 近日中に掲載予定
	耐マイグレーション性	85°C, 85% RH, 0.5mm, 50V (1440h)	近日中に掲載予定
	冷熱衝撃試験	-65°C ⇄ 125°C (100サイクル)	近日中に掲載予定
	高温放置試験	105°C, 1000時間	近日中に掲載予定
	低温放置試験	-20°C, 1000時間 (実施中)	近日中に掲載予定
その他	補強板	対応	対応
	表面処理	酸化防止処理 無電解金めっき (オプション)	酸化防止処理 無電解金めっき (オプション)
			種類(パターン幅, 膜厚や屈曲半径)によって大きく異なる 左記と同程度 -25°C ⇄ 85°C (1000サイクル) 等 85°C, 1000時間等 -20°C, 1000時間 無電解金フラッシュ (ENIG) 錫めっき、銀めっきなど多数